**各位 お問い合わせ先**

テリー・エマーソン

（Terry Emerson）

[terry.emerson@samtec.com](mailto:terryemerson@samtec.com)

812-981-8304

**[SAMTEC LOGO] 2019年3月**

**Samtec社、設計の柔軟性を高める超小型パワーコネクタを発表**

ピッチ2.00mmの超小型ハイパワーコネクタで省スペース化

**インディアナ州ニューアルバニー：**Samtec社は、電源のみ、または電源／信号向けに、設計の柔軟性を大きく向上させる究極の小型ハイパワーソリューションとしてmPOWER™を発表しました。ピッチ2.0mmのパワーコネクタシステム（UMPT/UMPS）は、スモールフォームファクタを特長とし、ブレード当たり最大18アンペアを実現します。

この小型ハイパワーシステムは、基板の省スペースだけでなく、非常に高いインチ当たりアンペア数に対応します。ラージフォームファクタでブレード当たり20アンペアに対応する従来のパワーコネクタに比べて、mPOWER™は、約半分のサイズでブレード当たり18アンペアに対応するので、基板の空いたスペースをほかの部品に使用することも可能となるほか、パッケージサイズを小型化することも可能です。

スタック高の種類が豊富であるため、mPOWER™は、独自の2ピース電源および信号／グラウンドソリューションを提供するSamtec社の高速コネクタシステムとともに、新規または既存のアーキテクチャに簡単に追加できます。スタック高の種類は5mmから12mmですが、他の高速コネクタシステムとの互換性を高めるためにスタック高16mmも開発中です。AcceleRate® HD、Edge Rate®、SEARAY™、SEARAY™ 0.80mm、LP Array™、Q Strip®、Q2™、Tiger Eye™等のSamtec社の高速システムと互換性があります。

2、3、4、5枚のパワーブレード（最大10枚の構成を開発中）を選択可能で、設計柔軟性のさらなる向上が可能です。標準は、マットスズまたは10ミクロン金メッキ、特別な規制対応のために、オプションで30ミクロン金メッキが可能です。また、パワーブレードは、2段階の嵌合を持ち、特別な沿面やクリアランス要求を達成するために選択的にロードできます。オプションの溶接タブで、基板上の安定性が向上します。

Samtec社の小型堅牢製品マネージャであるテリー・エマーソンは次のように述べています。「Samtec社のパワー製品のポートフォリオにmPOWER™が加わるのは素晴らしいことです。mPOWER™は、どのような信号コネクタでも電源／信号コンボに変換できる製品です。本製品は多くの産業用途に適しており、あらゆる用途で小型化に貢献するものです。」

mPOWER™コネクタは、ポジション数2から10の直角タイプ、また、垂直および直角端子の両方と嵌合するソケットケーブルアセンブリを含む多様なオプションを開発中です。

詳細は、当社ウェブサイトの[mPOWER™ Ultra Micro Power Connectors](https://www.samtec.com/connectors/micro-pitch-board-to-board/rugged/ultra-micro-power) のページをご覧ください。

**Samtec, Inc.について：**

1976年創業のSamtec社は、非上場企業で、年間売上高は8億2,200万ドルに上ります。高速ボード・ツー・ボード、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネル・オプティクス、フレキシブル・スタッキング、小型/堅牢部品およびケーブル等、幅広い電子インターコネクト・ソリューションの製品を有する、世界的な製造業者です。Samtec テクノロジー・センターは、ベアダイから距離100メートルのインターフェースまでのシステムおよびその間のあらゆるインターコネクトポイントに関して、性能・コスト共に最適化するための、技術、戦略および製品の開発・高度化に注力しています。全世界で40を超える国際拠点を有し、125を超える国々で製品販売を行っており、Samtec社の世界的なサポート体制が比類なき顧客サービスの提供を可能としています。より詳しい情報は、Samtec社ウェブサイトをご覧ください（<http://www.samtec.com>）。

**Samtec, Inc.**

**P.O. Box 1147**

**New Albany, IN 47151-1147**

**USA**

**電話：1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)**

www.samtec.com